03/17/2003 14:26 9252948147 Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

04214650

PUBLICATION DATE

05-08-92

APPLICATION DATE

: 12-12-90

APPLICATION NUMBER

: 02401469

APPLICANT : NEC KYUSHU LTD;

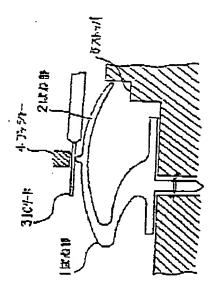
INVENTOR : KAWAHARA SHOICH!;

INT.CL.

: H01L 21/66 G01R 1/067 G01R 31/26

TITLE

: CONTACT FOR AUTOHANDLER USE



ABSTRACT : PURPOSE: To obtain a stable contact pressure by means of a short stroke by a method wherein a stopper with which the tip of a spring part comes into contact by means of a stroke by a pusher is installed and a spring constant is changed before and after the spring part comes into contact with the stopper.

> CONSTITUTION: A spring part 1 is a spring part which is always subjected to a pressure; and a contact pressure with an IC lead 3 is obtained in such a way that it is proportional to a stroke by a pusher 4 which presses the IC lead 3. When the stroke by the pusher 4 is made much longer, a spring part 2 is supported by a stopper 5. After that, a contact pressure in which a spring constant by the spring part 1 and that by the spring part 2 have been composed is obtained. In this manner, one contact is provided with two spring parts whose spring constants are the same or different, and one or both spring parts are used. Thereby, the contact pressure form a weak one to a strong one by means of a short pressure stroke can be changed without replacing the contact.

COPYRIGHT: (C)1992.JPO&Japio

9252948147

(19)日本運輸制(JP) (22) 公開特許公報(A)

(11)特許出資公庭等等

特開平4-214650

(43)公開日 平章4年(1992)8月5日

(S1) int Q13 H01L 21/65	医对脑炎 G	庁内空理会學 7013 − 4M	Fl	益标表示简照
G012 1/057 31/26		9016—2G 8411—2G		

名重請求 完装求 請求項の数1(会 3 頁)

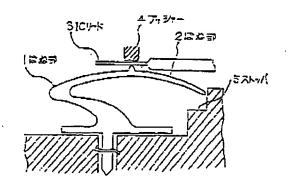
(21) 出願祭号	台灣产2-40146 2	:	(71) 出菜人	000164450
(22) 出版日	平成 2 年 (1990) 12月12日		(72) 异螟者	九州日本電気栄工会社 駐本県政本市八場町100会地 河原 2年 駐本県部本市八場町100会地九州日本電気
			(74)代惡人	林工会社内 井里士 内原 五
•		18		-

(54) 【無明の名称】 オートハンドラ用結動デ

(57) [喜韵]

【術成】ブッシャー4を押し下げICリード3をばね部 1 に押圧接触させるストローク途中で、ばね部2の光楽 が当位するストッパー5を設け、その後のストロークに 対しばれた弦を変化させている。

【効果】塩かい非ビストロークで弱い接触にから強い接 触圧点で変化させることができるので、ば白部の変形も 少たくでする。また決性抵抗も小さく安定した電気特性 試験を行たうことができる。



(2)

特朗平4-21465D

【特許記述の範囲】

【除え項1】 「Cリードをブッシャーにてばね部に押 圧銃艦させるオートハンドラ用機競子において、ブッシ ナーのストロークによりば塩部の先増を当接させ、ばね 定数を変化させるためのストッパを控けたことを特徴と するオートハンドラ用接触学。

9252948147

「発明の詳細な説明」

100011

[炭素上の利用分析] 本党明は I C製造工程に用いるオ ートハンドラ尼採脸子に関するものである。

(0002)

【従来の芸術】 従来のオートハンドラ用接触子は、図3 の経断面質に示すように、ばね定数が一定の板ばね状の ばね節1を1つだけ寄し、10リード3をブッシャー4 で钾圧してばね却1に独無させている。

[0003]

[発明が解決しようとする課題] 従来のオートハンドラ **用接触子では、ICリードとの接触圧は押ごするブッシ** キーのストローケとの進例関係にあるだけで、 塾い投触 ね性の強い到の危軽子と交換する必要があった。

【0004】また、押圧するストロークを撤壊に増した 場合は長期間の使用でそのは熱性が変化し、安定した接 **熱圧を得ることができなくなり、ICリード間との指触** 抵抗が冷し、最気特性が劣化してしまうという問題点が あった。 また、別の接触子と交換する場合は、その交換 に要する時間が長時間必要となり、高価な宏備を長時間 存止させたければならないという問題点もあった。

【課題を解決するための学会】本英明のオートハンドラ 20 る。 用途単字は、プッシャーのストロークによにばね部の先 増を当抜きせるためのストッパを受け、ばね部がこのス トッパに当たる前と後ではね足数を変化させて、屋から ストロークで安定した接触圧が得られるようにしてい ā.

[0006]

【兵旋列】次に本党明の一条結例を図面を用いて説明す

る。 図1 は本発明の一貫範例を示すオートハンドラ用袋 無子の経断両國である。1本の接触子には加定数が同一 または異なる2つのば如部を有している。ば四部1は含 に押圧を受けるばね部であり、10リード3を押えるブ ッシャー 4のストロークに比例して1 Cリード2との法 庶圧が待られる。 プッシャー4のストロークを更に長く すると、図2に示す様に、ばね部2がストッパ5に支持 され、以降はばね前1とばわ前2の持つばね定数が合足 された接触圧が得られる。

10 [0007]

【発明の効果】以上説明したように太常明のオートハン ドラ用接触子は、1本の接触子に同一会たは異ならば絶 定数を持つ2つのは始節を持ち、これを一方文は双方と も使用することにより、意かい特圧ストロークで弱い技 **歴圧から強い信触圧変で、接触子を交換することなく変** 化させることができる。

【0008】従って、強い接触圧を得る為に、押圧入ト ロークを曇くして接触子の変形を超くことも少なくな り、铁粒抵抗も小さく、失定した電気特性試験を行なう 圧を得る為には押圧するストロークを極端に増すか、ば、20 ことができるという効果がある。更に、極い芸性圧から 強い接触圧を得る為に、接触子を長時間かけて交換する 必要もない為、高価な政情を有効に使用できるという効 果がある。

【図両の簡単な記明】

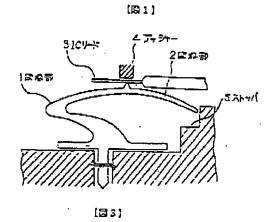
- 【図1】本発明の一気施興の動作前を示す機断両図であ
- 【康2】本発明の一集施興の動作甚至宗す最新面図であ
- 【図3】 花来のオートハンドラ用接触子の経断面図であ

【行号の記録】

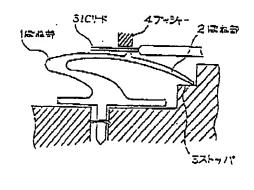
- 1 花추れ
- 2 バネ部
- 3 ICU-B
- 4 プッシャー
- ストッパ

(3)

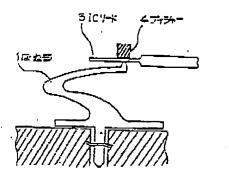
特殊平4~214550



9252948147



【图2]



⑲日本园特許庁(JP)

①実用新案出颠公開

@ 公開実用新案公報 (U)

平4-70746

®Int. Cl. 5

建別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)6月23日

H 01 L G 01 R 21/66 1/067 1/073

₿ Ā 7013-4M 9016-2G 9016-2G

審査請求 有 請求項の数 2 (全 頁)

母考案の名称

プロープカード

②実 颐 平2-114290

❷出 颐 平2(1990)10月30日

②考 案 者 大 久 保

兵庫県尼崎市西長洲本通3丁目1番地 日本電子材料株式

会社内

個考 案 者 村上

信 行

昌男

兵庫県尼崎市西長洲本通3丁目1番地 日本電子材料株式

全社内

の出 類 人 日本電子材料株式会社 囟代 理 人 弁理士 大西 孝冶

兵庫県尼崎市西長洲本通3丁目1番地

明細書

- 1. 考案の名称 プローブカード
- 2. 実用新案登録請求の範囲
- (1) 半導体集積回路装置の電気的諸特性を測定する際に用いられるプロープカードにおいられるプロープカードにおいられる関係に開設された開口の周縁部に対けられるを引きない。 立ており、前記探針は半導体集積回路接近の大流の接触がより、は、半導体集積回路接近のが、半導体集積回路をでいることを特徴とするプローブカード。
- (2)前記探針は全体が略クランク形状に折曲形成され、かつ接触部はパッドに対して垂直に接触することを特徴とする請求項1記載のプローブカード。
- 3. 考案の詳細な説明 <産業上の利用分野>

530 実開4- 70746

本考案は、半導体集積回路装置の電気的諸特性 の測定の際に用いられるプロープカードに関する。 <従来の技術>

従来のプローブカードを第5図及び第6図を参照しつつ説明する。

プローブカードは、基板10とこの基板10に開設された開口11の周縁部に嵌め込まれるリング20と、このリング20に放射状にエポキシ系樹脂40で取り付けられる複数の探針30とを有している。

リング20の下面、すなわち探針30が取り付けられる面21は、中心に向かって傾斜しているので、このリング20に取り付けられる探針30は、半導体集積回路装置50に対して斜めに取り付けられることになる。

しかも、探針30の先端たる接触部31は、半導体 集積回路装置50の電極たるパッド51に対して斜め 方向から接触するように折曲形成されている。 <考案が解決しようとする課題>

上述したような従来のプローブカードには、以 下のような問題点がある。



すなわち、電気的諸特性の測定時には、すべて の探針30を確実に所定のパッド51に接触させるべ く接触部31がパッド51に接触してからも、さらに プローブカードを押し下げている(以下、これを 『オーバードライブ』とする)。

かかるオーバードライブ時に、探針30の接触部 31がパッド51の上を滑ってこれを傷つけることが ある(第6図参照)。これは、接触部31がパッド 51に対して斜めに接触しているためである。

パッド51の傷511 は、特に小さいパッド51のワ イヤポンディング時に問題になる。すなわち、パ ッド51に対して傷が大きいため、ボンディングワ イヤが確実に圧着される部分が少なくなるのであ る。また、傷の上にポンディングワイヤを圧着で きたとしてもはかれ易いのである。

さらに、多数回の測定を行ううちに、パッド51 の削りかすが探針30の接触部31に付着し、測定結 果に悪影響を及ぼすこともある。

また、先端の接触部31の折曲角度の製造管理が 難しい。

03/17/2003 14:26

公開実用平成 4-70746

本考案は上記事情に鑑みて創案されたもので、 オーバードライブを加えても、探針の接触部のパ ッド上での滑りを極小に抑えることができるプロ ープカードを提供することを目的としている。

<課題を解決するための手段>

本考案に係るプローブカードは、半導体集積回 路装置の電気的諸特性を測定する際に用いられる プローブカードであって、基板に開設された開口 の周縁部に取り付けられるリングと、このリング に取り付けられる探針とを備えており、前記探針 は半導体集種回路装置に対し平行に取り付けられ るとともに、当該探針の先端の接触部は、半導体 集積回路装置のパッドに垂直に接触すべく直角に 折曲形成されている。

く作用>

接触部が半導体集積回路装置のパッドに接触し てから、25~50μα のオーバードライブを加える。 このオーバードライブによって、探針の先端部分 は変形するが、接触部のパッド上の滑りを極小に 抑えることができる。

<実施例>

以下、図面を参照して本考案に係る一実施例を 説明する。

第1図は本考案の一実施例に係るプローブカードの要部を示す概略的断面図、第2図はこのプローブカードの使用状態を示す概略的断面図、第3図はこのプローブカードによるパッドの傷を示す平面図、第4図は他の形状の探針を示す正面図である。

本実施例に係るプローブカードは、半導体集積回路装置50の電気的諸特性を測定する際に用いるれるものであって、基板10に開設された開口11の周縁部に取り付けられるリング20と、このリング20に取り付けられる探針30とを備えており、前記探針30は半導体集積回路装置50に対し平行に取り付けられるとともに、当該探針30の先端の接触部31は、半導体集積回路装置50のパッド51に垂直に接触すべく直角に折曲形成されている。

基板10の略中央部には、段差を有する開口11が 開設されている。また、当該基板10には図示しな

いプリント配線が形成されている。

リング20は、絶縁性材料で形成されており、前記開口11に嵌め込まれるように良差が形成されている。このリング20の下面、すなわち探針30が取り付けられる面21は基板10の裏面に対して面一になる。すなわち、リング20の面21は半導体集積回路装置50に対して平行に設定されているのである。

探針30は、前記面21にエポキシ系樹脂40で取り付けられる。かかる探針30の先端は、接触部31として直角方向に折曲形成されている。すなわち、この探針30は半導体集積回路装置50に対して平行にリング20に取り付けられ、接触部31は半導体集積回路装置50に対して垂直に垂下されているのである。

さらに、当該接触部31は、先端になるに従って 細く形成されており、当該探針30は終端部(図示 省略)で前記プリント配線に接続されている。

次に、かかるプローブカードの作用について説 明する。

接触部31が半導体集積回路装置50のパッド51に

接触してから、25~50 μm のオーバードライブを加える。

すると、探針30は第2図に示すように、基端側が変形するが、接触部31のパッド51の上での滑りは極小になる。従って、パッド51に傷がついたとしても、第3図に示すように最小の傷511、すなわち接触部31と同じ大きさですむ。

次に、上述したのとは異なる形状の探針35について、第4図を参照しつつ説明する。

この探針35は、上述した探針30とは違って全体が略クランク形状に折曲形成されている。なお、かかる探針35であっても、接触部31は半導体集積回路装置50のパッド51に対して垂直に接触するように直角に折曲形成されている。

かかる探針35は、半導体集積回路装置50の内側 にパッド51が存在する場合に使用する。すなわち、 第1図に示された探針30を乗り越えるようにして リング20に取り付けられるのである。

なお、上述した実施例では、リング20の面21は、 半導体集積回路装置50に対して平行に設定されて

としたが、本考案がこれに限定されるわけではない。例えば、従来のリング20のように面21が傾斜していても、エポキシ系樹脂40の塗布量の調整等により探針30が半導体集積回路装置50に対して平行になるように取り付けられればよい。

く考案の効果>

本考案に係るプローブカードは、基板に開設された開口の周縁部に取り付けられるリングと、このリングに取り付けられる探針とを備えており、前記探針は半導体集積回路装置に対し平行に取り付けられるとともに、当該探針の先端の接触がは、半導体集積回路装置のパッドに垂直に接触すべく直角に折曲形成されているので、測定時にオーバードライブを加えても、接触部のパッド上での滑りを極小にすることができる。

従って、パッドの傷を極小に抑えることができ、 従来の傷よりはかなり小さいものになる。このため、多数回の測定を行っても、接触部に付着する 削りかすは少なく、従来のものより長期間使用す ることができる。また、探針自体の摩耗も少ない。

PAGE 16/20

さらに、接触部は直角に折曲形成されるので、 折曲角度の管理が行い易く、コスト低減にも貸献 することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案の一実施例に係るプロープカードの要部を示す概略的断面図、第2図はこのプローブカードの使用状態を示す概略的断面図、第3図はこのプローブカードによるパッドの優を示す正面図、第4図は他の形状の探針を示す正面図、第5図は従来のプロープカードの要部を示す概略的断面図、第6図はこのプロープカードによるパッドの傷を示す平面図である。

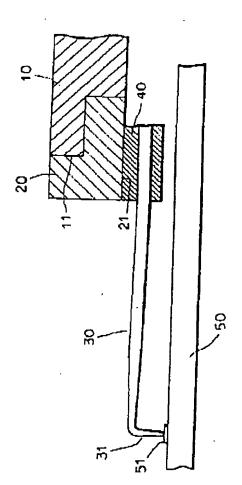
10・・・基板、11・・・開口、20・・・リング、 30、35・・・探針、31・・・接触部、50・・・半 導体集積回路装置、51・・・パッド。

実用新案登録出顧人 日本電子材料株式会社 代 理 人 弁理士 大 西 孝 治 tea more color

図一株

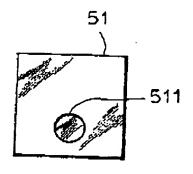
公開実用平成 4-70746



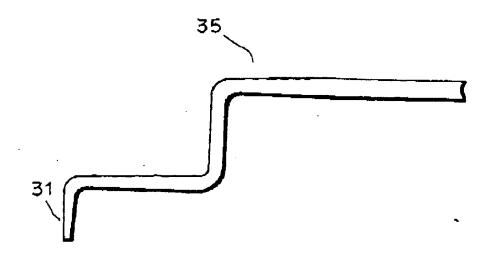


図録

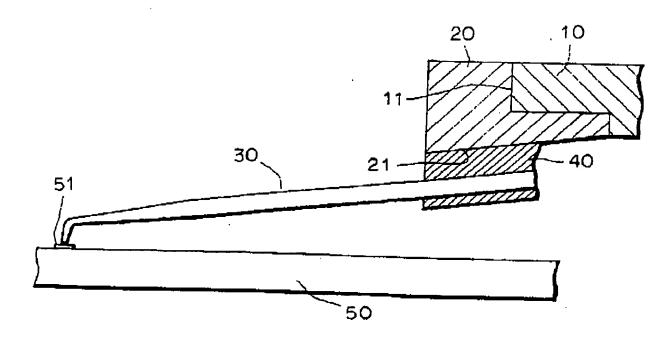
公開実用平成 4-70746



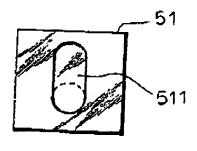
第3図



第4図



第5区



第6図

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:			
☐ BLACK BORDERS			
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES			
FADED TEXT OR DRAWING			
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING			
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES			
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS			
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS			
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT			
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY			
D common			

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.